

证券代码：688403

证券简称：汇成股份

公告编号：2023-021

合肥新汇成微电子股份有限公司

关于募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“汇成股份”）于2023年5月29日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十次会议，审议并通过了《关于募投项目延期的议案》，一致同意公司根据实际情况，综合考虑当前募集资金投资项目的实施进度等因素，对首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“12吋显示驱动芯片封测扩能项目”和“研发中心建设项目”预计达到预定可使用状态的时间进行延期。

本次募投项目延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。公司独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构海通证券股份有限公司出具了明确的核查意见。该事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2022年6月15日出具《关于同意合肥新汇成微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1256号），公司获准首次向社会公开发行人民币普通股（A股）16,697.0656万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格8.88元，募集资金总额为人民币148,269.94万元，扣除不含税发行费用16,233.98万元后，实际募集资金净额为人民币132,035.96万元。上述募集资金已于2022年8月12日到账，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新

股的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 8 月 12 日出具了《验资报告》（天健验〔2022〕412 号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并由公司与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。具体情况详见 2022 年 8 月 17 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》以及公司于 2022 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2022-001），截至 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资预算总额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额	实施主体	截至 2022 年 12 月 31 日累计投入金额
1	12 吋显示驱动芯片封测扩能项目	97,406.15	97,406.15	78,000.00	汇成股份	51,111.51
2	研发中心建设项目	8,980.84	8,980.84	5,000.00	汇成股份	814.00
3	补充流动资金	50,000.00	50,000.00	49,035.96	汇成股份	49,036.40
合计		156,386.99	156,386.99	132,035.96	-	100,961.92

公司募投项目实施进展情况详见公司于 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-006）。

三、本次募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次募投项目延期情况

公司结合目前募投项目的实际进展情况，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

项目名称	原计划达到预定可使用状态的时间	调整后达到预定可使用状态的时间

12吋显示驱动芯片封测扩能项目	2022年12月	2023年12月
研发中心建设项目	2023年06月	2023年09月

（二）本次募投项目延期的原因

公司募投项目建设的主要内容为集成电路封装测试设备购置、安装及调试，设备采购的下单时间及付款时间直接影响着募集资金使用和募投项目实施进度。“12吋显示驱动芯片封测扩能项目”所需购置设备以高值、先进的测试机、探针台等进口设备为主，公司发出采购订单后，设备供应商备货时间周期较长，特别是部分高阶设备产能较为紧张，设备供应商在手订单较多，进一步延长了设备交期。“研发中心建设项目”实施过程中的设备选型及安装调试工作不断优化，同时受国内外经济环境的持续影响，公司在实施项目的过程中相对谨慎，根据下游市场及客户需求的变化适时调整项目实施进度及研发方向。

因此，经过综合分析和审慎评估，结合当前项目的实际情况，公司董事会决定将“12吋显示驱动芯片封测扩能项目”达到预定可使用状态的预计时间延期至2023年12月，将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的预计时间延期至2023年9月。

四、本次募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。本次募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司正常经营活动造成重大不利影响，符合公司长期发展规划，符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

五、审议程序及专项意见

（一）审议程序

公司于2023年5月29日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，分别同意公司对募投项目“12吋显示驱动芯片封测扩能项目”和“研发中心建设项目”预计达到预定可使用状态的时间进行延期。该事项不属于募集资金用途变更的情形，无需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事一致认为：公司本次将“12吋显示驱动芯片封测扩能项目”和“研发中心建设项目”延期是公司根据募投项目实施过程中的内外部实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营情况，不会对公司的正常经营产生重大影响，决策和审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司本次募投项目延期的事项。

（三）监事会意见

监事会认为：公司本次募投项目延期是公司在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，根据募投项目实施过程中的内外部实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。因此，公司监事会同意公司募投项目延期的事项。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定。本次募投项目延期是公司根据实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司正常经营活动造成重大不利影响，符合公司长期发展规范。保荐机构对汇成股份募投项目延期事项无异议。

特此公告。

合肥新汇成微电子股份有限公司董事会

2023年5月31日